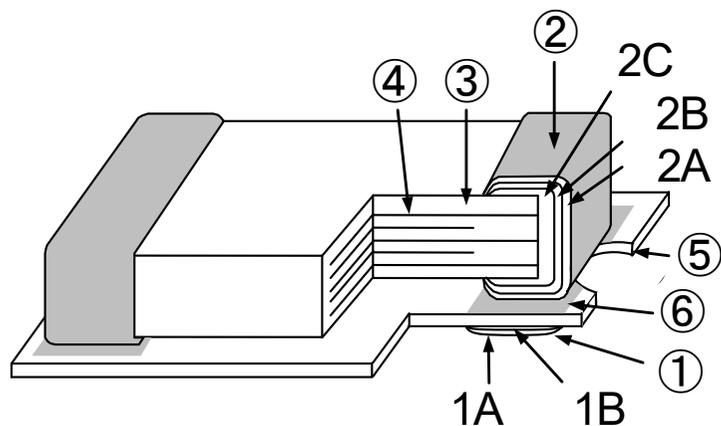


インターポザ基板付きチップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表

Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor on Interposer

<ZRA Series>

1.内部構造/Structure



2.材料名/Material

No.	名称 Name	材料/Material
①	外部電極/Termination	
	1A めっき層/Plated layer	すず/Tin
	1B 下地電極/Electrode	銅/Copper
②	MLCC 外部電極/MLCC Termination	
	2A MLCC めっき層/MLCC Plated layer	すず/Tin
	2B MLCC めっき層/MLCC Plated layer	ニッケル/Nickel
	2C MLCC 下地電極/MLCC Electrode	銅/Copper
③	MLCC 誘電体素子/MLCC Dielectric layer	チタン酸バリウム系/Barium titanate-based
④	MLCC 内部電極/MLCC Inner electrode	ニッケル/Nickel
⑤	インターポザ基板/Interposer	ガラスエポキシ/Glass Epoxy
⑥	接続はんだ/Solder	無鉛はんだ(すず・銀・銅系)/ Lead Free Solder(Tin-Silver-Copper series)

J(E)MCZ0-1R0684D

<ご参考> 当社ウェブサイトにて、各シリーズの最新の構造図を手いいただくことが可能です。 → [構造図/材料表](#)

<Reference> The latest structure diagrams of each series are available on our website. → [Structure diagram, Materials chart](#)